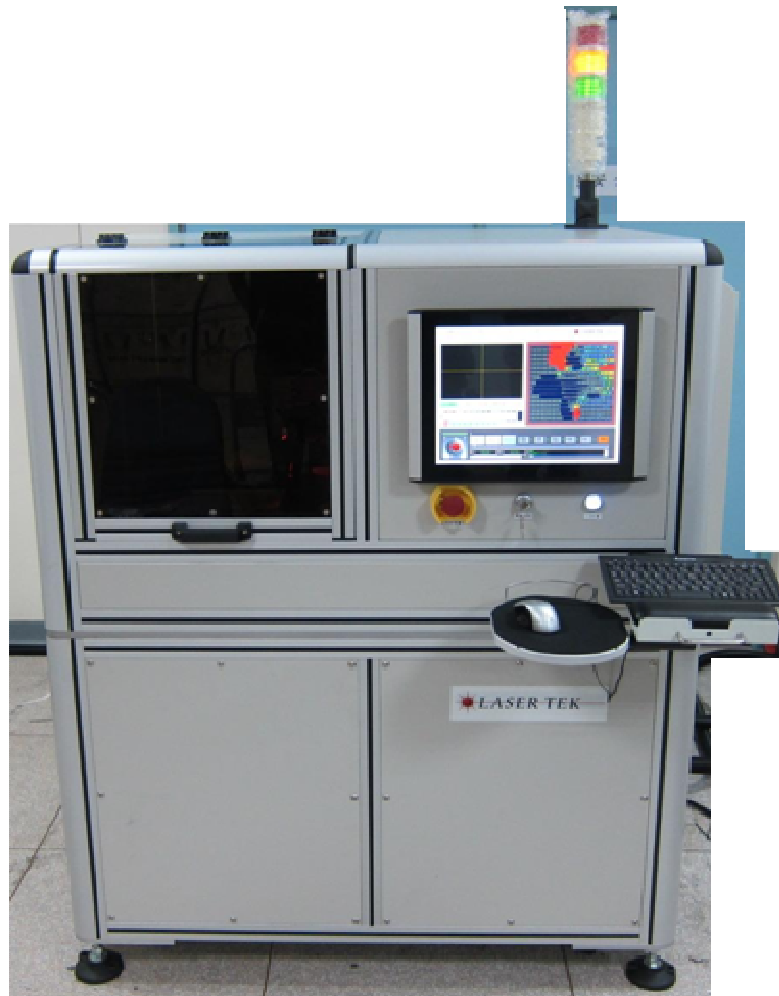




最佳解決方案—

滿足您多樣化需求的鐳射除膠機



尺寸: 113x65x134cm 機器重量: 350kgs(Approx.)

Laser Marking System LM-C10-AZ200

No. 248-39, Shin-Sheng Road. Chien-Zhen District, Kaohsiung, Taiwan

TEL: +886-7-9510828 FAX: +886-7-9510820

● 鐳射除膠的特色：

§非接觸式加工，無刀具更換及斷裂磨耗問題。

§永久性標記，除膠效果精緻美觀，提升產品質感。

§電腦繪圖，少量打樣免開模製版之困擾。

§適用材料廣泛，無材料硬度之限制。

§物件表面不需清潔處理，可直接進行除膠，簡化生產流程。

§可直接於曲面加工。

§自動化設計周全，大量小量生產皆適宜。

§提供自動影像對位,確保產品準確放置,自動測高感測器辨識加工件焦距,提供適當加工參數

給鐳射軟件,已達準確除膠之目的

● 適用材料：

各種非金屬如玻璃、塑膠、壓克力、木材、鍍膜、烤漆、噴漆、電鍍、陽極處理、貼紙...等材料；電子零件、IC、PCB 板、銘板、鈕扣、光碟片、連接器、包裝材料、相框、布料...等產品。

● 特性說明：

§最新型高速高精度除膠頭，採用德國 Scanlab dynAXIS 系列掃描馬達。

§紅光導引預覽功能，便於除膠前將物件正確定位。

§程式控制鐳射功率，並可自動儲存紀錄，後續使用時自動將功率調整至原設定值，無須另行記錄來作為使用參考。

§全中文設計，30 分鐘即可學會操作，大幅縮短教育訓練的時間。

§人性化使用者操作介面，簡便易學易用，僅需填入相關參數即可完成設定。

§強大的繪圖功能，除了基本的線段、圓弧、圓形與矩形外，並有曲線繪圖功能來進行不規則圖形繪製。繪圖完成設定相關參數即可進行除膠，簡化作業流程。

§功能完整的排版設計，可自由拖拉與縮放尺寸、位置、角度、旋轉、鏡射等，以及各種文字排列與圓弧排列，並可輕易完成矩陣設定做一次多個物件除膠。

§提供完善的一維條碼與二維條碼除膠，並可使用流水號模式進行條碼除膠。

§具有群組功能，可將多個物件進行群組，使用共同的鐳射參數以簡化設定。

§完整的 I/O 設計，可自行規劃各 I/O 之代表功能並透過即時的監控畫面了解 I/O 訊號連結情形，與周邊系統連結簡單容易。

§包含自動測高 Sensor, 影像視覺對位 camera for 定位點確認及位置補償 200mmx200mm XY 移動平台，及抽風機構

精巧的鐳射除膠系統—

系統整合、自動化的好幫手

詳細規格:

鐳射除膠機尺寸 Size(cm)	113x65x134cm	
鐳射波長 Wavelength	10.6 um	
鐳射形式 Laser Type	Sealed, RF Excited CO2 Lase	
鐳射模式 Beam Mode	TEM00,95% Purity, $M^2 < 1.2$	
輸出功率 Output Power (max.)	10 Watts	
頻率調變 Pulse Width Modulation	~20KHz	
除膠範圍 Field Size (mm)	70X70	
除膠線寬度 Spot Size (um)	130	210
鐳射頭尺寸 Dimensions of Laser Head(mm)	760(L)X173(W)X236(H)	
鐳射頭重量 Weight of Laser Head(Kg)	15	
冷卻需求 Cooling Requirement	風扇強制冷卻	
電力需求 Electrical Power	1ϕ100~200VAC , 20/60 Hz , 2.5AMP	
控制介面 Control interface	16Bit Analog PCI Bus 或 Bit Digital USB Mode	
電腦需求 PC Requirement	Pentium 以上，含光碟機，軟碟機，鍵盤，滑鼠 螢幕，USB Port，PCI Slot	

※ 規格因技術需要而變動數不另行通知※